

μ PC2747TB, μ PC2748TB

3 V, 移動体通信機用 小型ミニモールド シリコン高周波増幅器 IC

μ PC2747TB, μ PC2748TB はセルラ・コードレス電話のローカル増幅用などに開発したシリコン・モノリシック IC です。電源電圧 3 V で動作するためシステムの低消費電力化に最適です。

本製品は、当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「NESAT[®] III」($f_T = 20$ GHz) により生産しています。本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜や金電極構造を採用しています。この構造はチップの耐湿性、耐食性に優れ、良好な電流特性、高周波特性を有しています。これにより電氣的特性、信頼性に優れた高品質の IC となっています。

特 徴

電源電圧	: $V_{CC} = 2.7 \sim 3.3$ V
雑音指数	: μ PC2747TB ; NF = 3.3 dB TYP. @ $f = 900$ MHz μ PC2748TB ; NF = 2.8 dB TYP. @ $f = 900$ MHz
電力利得	: μ PC2747TB ; $G_P = 12$ dB TYP. @ $f = 900$ MHz μ PC2748TB ; $G_P = 19$ dB TYP. @ $f = 900$ MHz
動作周波数	: μ PC2747TB ; DC ~ 1.8 GHz μ PC2748TB ; 0.2 ~ 1.5 GHz
高アイソレーション	: μ PC2747TB ; ISL = 40 dB TYP. @ $f = 900$ MHz μ PC2748TB ; ISL = 40 dB TYP. @ $f = 900$ MHz
高密度・面実装が可能	: 6 ピン小型ミニモールド・パッケージ ($2.0 \times 1.25 \times 0.9$ mm)

用 途

PDC800 MHz, GSM などのローカル・バッファ

オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μ PC2747TB-E3	6 ピン小型ミニモールド	C1S	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング
μ PC2748TB-E3		C1T	・ 1, 2, 3 ピン側が送り丸穴 ・ 3 k 個 / リール

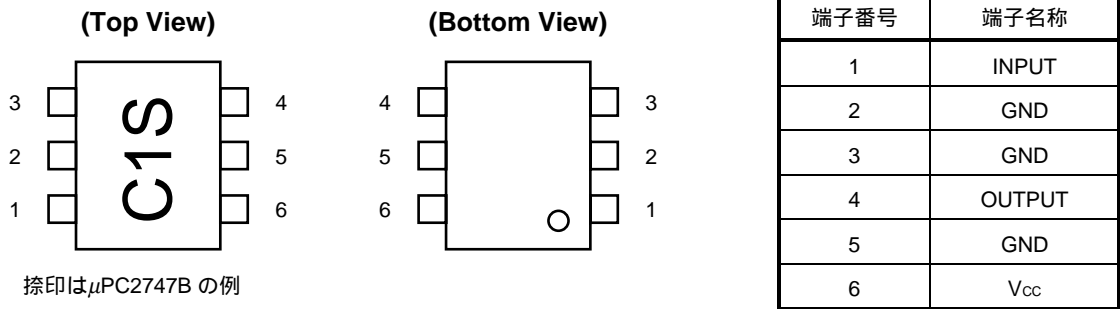
備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

サンプル名称 : μ PC2747TB, μ PC2748TB

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図



製品系列一覧 (T_A = +25°C, V_{CC} = 3.0 V, Z_s = Z_L = 50 Ω)

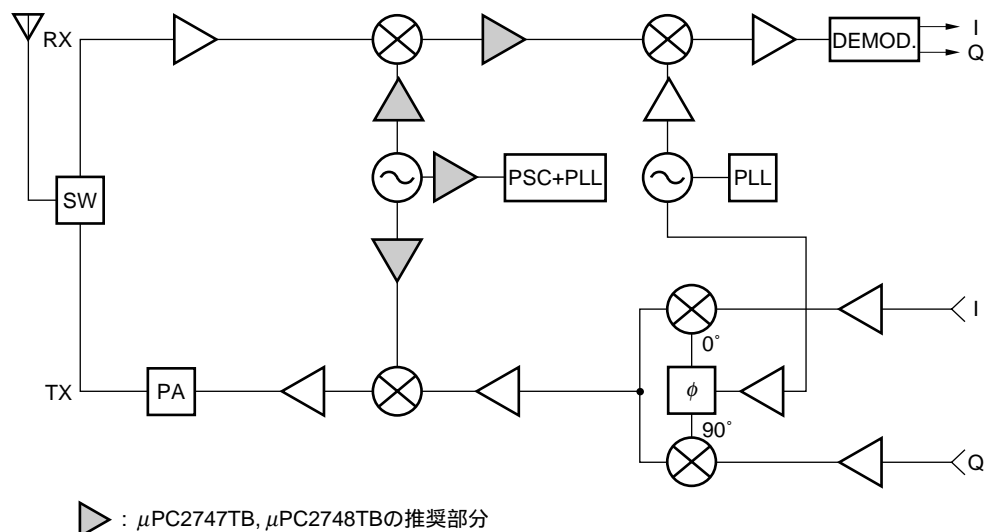
品名	f _u (GHz)	P _{O(sat)} (dBm)	G _p (dB)	NF (dB)	I _{cc} (mA)	パッケージ	捺印
μPC2745T	2.7	- 1.0	12	6.0	7.5	6ピン・ミニモールド	C1Q
μPC2745TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2746T	1.5	0	19	4.0	7.5	6ピン・ミニモールド	C1R
μPC2746TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2747T	1.8	- 7.0	12	3.3	5.0	6ピン・ミニモールド	C1S
μPC2747TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2748T	1.5	- 3.5	19	2.8	6.0	6ピン・ミニモールド	C1T
μPC2748TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2749T	2.9	- 6.0	16	4.0	6.0	6ピン・ミニモールド	C1U
μPC2749TB						6ピン小型ミニモールド	

備考 主要項目の TYP. 値。規格条件は電気的特性欄を参照。

注意 ミニモールド品と小型ミニモールド品は外形サイズのみで区別する。

システム応用例

デジタル・セルラの例



端子機能説明

端子番号	端子名称	印加電圧 (V)	端子電圧 (V) ^注	機能説明および使用法	内部等価回路
1	INPUT	-	0.80 ----- 0.80	入力端子です。 抵抗による 50 Ω マッチング回路を内蔵しているため広帯域で 50 Ω 接続が可能です。 カップリング・コンデンサを接続し、DC カットしてください。	<p>μPC2748TB の場合は * の抵抗なし。</p>
2 3 5	GND	0	-	グランド端子です。 グランド・パターンに接続してください。 グランド・パターンは最小インピーダンスとなるよう十分広くとってください。なお、各ピンのインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。	
4	OUTPUT	-	2.79 ----- 2.72	出力端子です。 抵抗による 50 Ω マッチング回路を内蔵しているため広帯域で 50 Ω 接続が可能です。 カップリング・コンデンサを接続し、DC カットしてください。	
6	Vcc	2.7 ~ 3.3	-	電源電圧端子です。 バイパス・コンデンサを接続し、高周波インピーダンスを小さくしてください。	

注 端子電圧は Vcc = 3.0 V 時の値。上段：μPC2747TB，下段：μPC2748TB

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	T _A = +25°C	4.0	V
トータル回路電流	I _{CC}	T _A = +25°C	15	mA
パッケージ許容損失	P _D	T _A = +85°C 注	270	mW
動作周囲温度	T _A		-40 ~ +85	°C
保存温度	T _{stg}		-55 ~ +150	°C
入力電力	P _{in}	T _A = +25°C	0	dBm

注 50×50×1.6 mm 両面銅箔ガラス・エポキシ基板実装時

推奨動作範囲

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧	V _{CC}	2.7	3.0	3.3	V

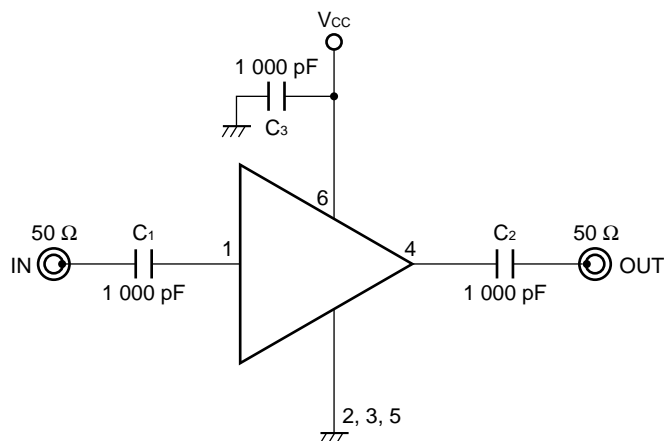
電気的特性 (特に指定のないかぎり T_A = +25°C, V_{CC} = 3.0 V, Z_S = Z_L = 50 Ω)

項目	略号	条件	μPC2747TB			μPC2748TB			単位
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
回路電流	I _{CC}	無信号時	3.8	5.0	7.0	4.5	6.0	8.0	mA
電力利得	G _p	f = 900 MHz	9	12	14	16	19	21	dB
雑音指数	NF	f = 900 MHz	-	3.3	4.5	-	2.8	4.0	dB
上限動作周波数	f _u	0.9 GHz のゲインより 3 dB ダウン	1.5	1.8	-	1.2	1.5	-	GHz
下限動作周波数	f _L	0.9 GHz のゲインより 3 dB ダウン	-	-	-	-	0.2	0.4	GHz
アイソレーション	ISL	f = 900 MHz	35	40	-	35	40	-	dB
入力側リターン・ロス	RL _{in}	f = 900 MHz	11	14	-	8.5	11.5	-	dB
出力側リターン・ロス	RL _{out}	f = 900 MHz	7	10	-	5.5	8.5	-	dB
飽和出力電力	P _{O(sat)}	f = 900 MHz, P _{in} = -8 dBm	-9.5	-7.0	-	-6.0	-3.5	-	dBm

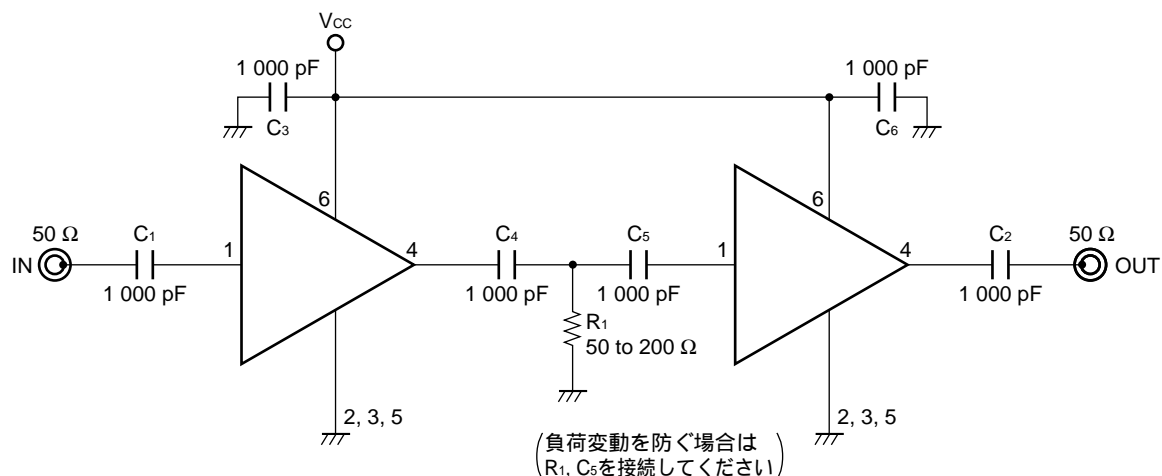
標準参考値 (TA = +25°C, Zs = ZL = 50 Ω)

項目	略号	条件	参考値		単位
			μPC2747TB	μPC2748TB	
回路電流	I _{CC}	V _{CC} = 1.8 V, 無信号時	3.0	3.5	mA
電力利得	G _p	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz	5.5	11.5	dB
雑音指数	NF	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz	5.2	4.5	dB
上限動作周波数	f _u	V _{CC} = 1.8 V, 0.9 GHz のゲインより 3 dB ダウン	1.8	1.5	GHz
下限動作周波数	f _L	V _{CC} = 1.8 V, 0.9 GHz のゲインより 3 dB ダウン	-	0.2	GHz
アイソレーション	ISL	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz	34	34	dB
入力側リターン・ロス	RL _{in}	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz	11	10	dB
出力側リターン・ロス	RL _{out}	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz	13	12	dB
飽和出力電力	P _{O (sat)}	V _{CC} = 1.8 V, f = 900 MHz, P _{in} = - 8 dBm	- 13.7	- 10.0	dBm
3 次相互変調ひずみ	IM ₃	V _{CC} = 3.0 V, P _{our} = - 20 dBm, f ₁ = 900 MHz, f ₂ = 902 MHz	- 34	- 38	dBc
		V _{CC} = 1.8 V, P _{our} = - 20 dBm, f ₁ = 900 MHz, f ₂ = 902 MHz	- 20	- 28	

測定回路図



応用回路例図



本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

Vcc 端子，入出力端子へのコンデンサの決定について

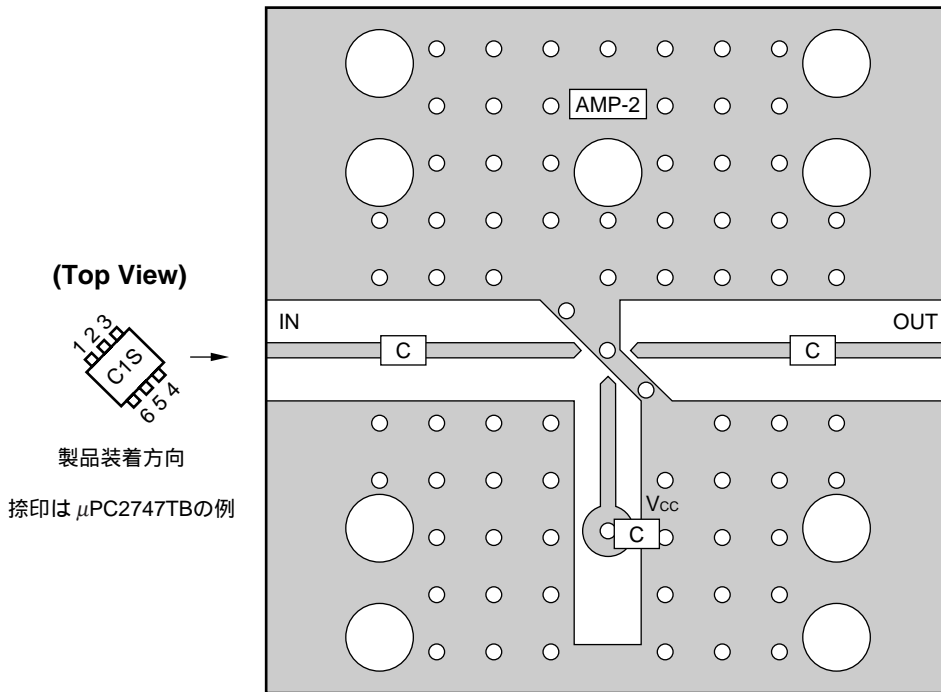
Vcc 端子へのバイパス・コンデンサ，入出力のカップリング・コンデンサはいずれも 1 000 pF 程度の値をご使用ください。

Vcc 端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は、Vcc 端子と GND 間のインピーダンスを 0 Ω に近付けるためです。これにより、電源電圧変動に対し、安定したバイアス状態にすることができます。

入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は、入出力端子と外付け回路を DC 的にカットするためで、50 Ω の負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。このコンデンサがハイパス・フィルタとなり、DC までの低い周波数をロスさせる訳です。

本製品の特性評価では 100 MHz 以上のゲインをフラットにした場合の周波数特性を確認するために 1 000 pF を用いています（実測上は 1 000 pF で約 10 MHz 程度までのフラット・ゲインが得られています。10 MHz より低い周波数範囲を含む帯域で使用する場合は $f_c = 1/(2\pi RC)$ の関係から各コンデンサの値を大きくしてください）。

測定回路のプリント基板例



部品表

	値
C	1 000 pF

基板例注釈

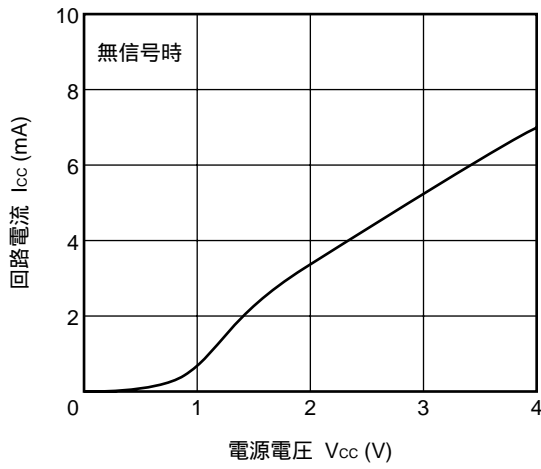
- (*1) 30×30×0.4 mmポリイミド板に両面35 μm厚銅パターンニング
- (*2) 裏面グランド・パターン
- (*3) パターンニング面は半田メッキ
- (*4) ○ ○ はスルー・ホール

本 IC の使い方の詳細についてはアプリケーション・ノート「6 ピン・ミニモールド, 6 ピン小型ミニモールド シリコン高周波広帯域増幅器 MMIC の使い方と応用」(P11976J) をご参照ください。

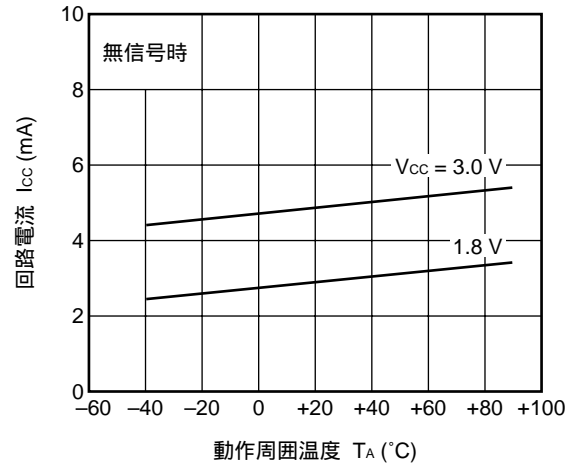
★ 特性曲線 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$)

- μ PC2747TB -

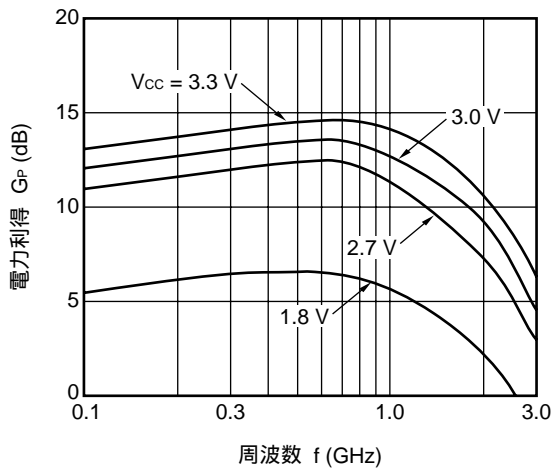
回路電流 vs. 電源電圧



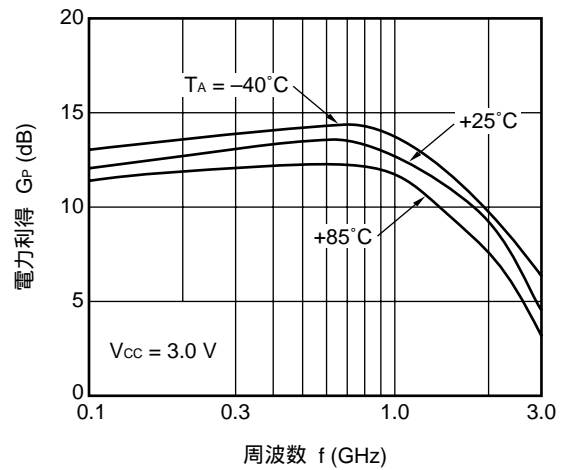
回路電流 vs. 動作周囲温度



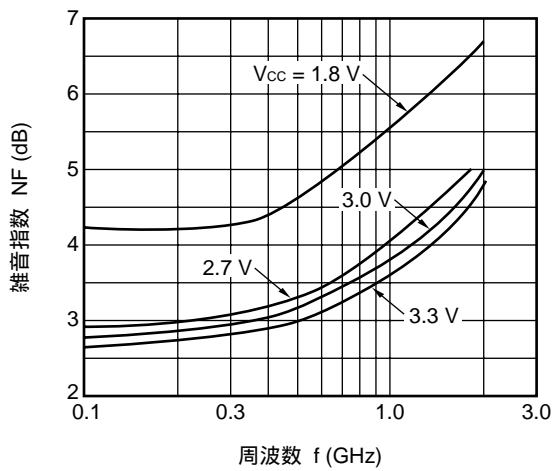
電力利得 vs. 周波数



電力利得 vs. 周波数

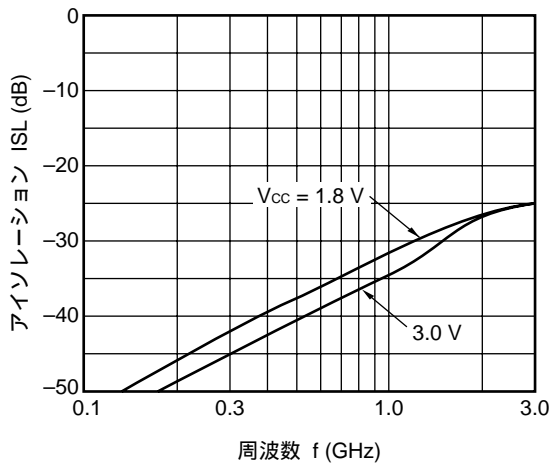


雑音指数 vs. 周波数

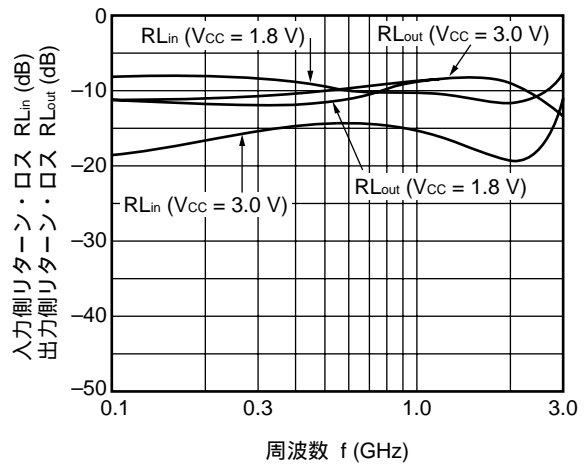


- μ PC2747TB -

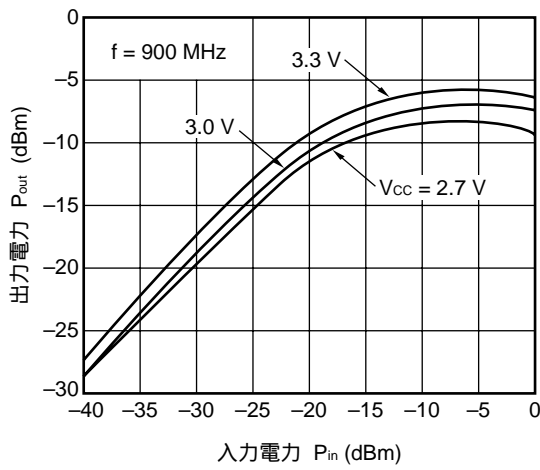
アイソレーション vs. 周波数



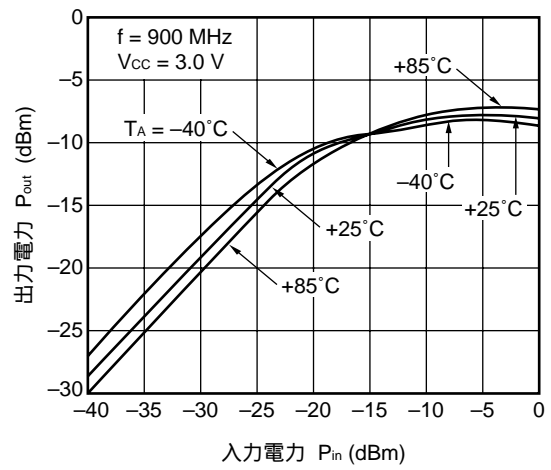
入力側リターン・ロス, 出力側リターン・ロス vs. 周波数



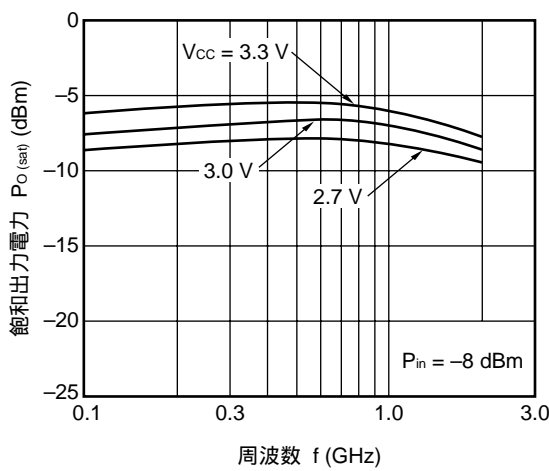
出力電力 vs. 入力電力



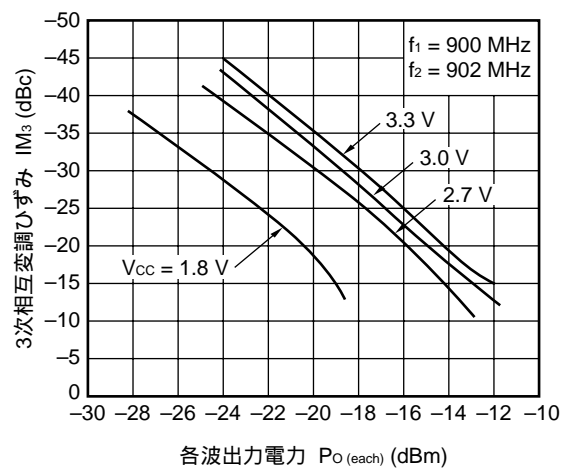
出力電力 vs. 入力電力



飽和出力電力 vs. 周波数



3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力

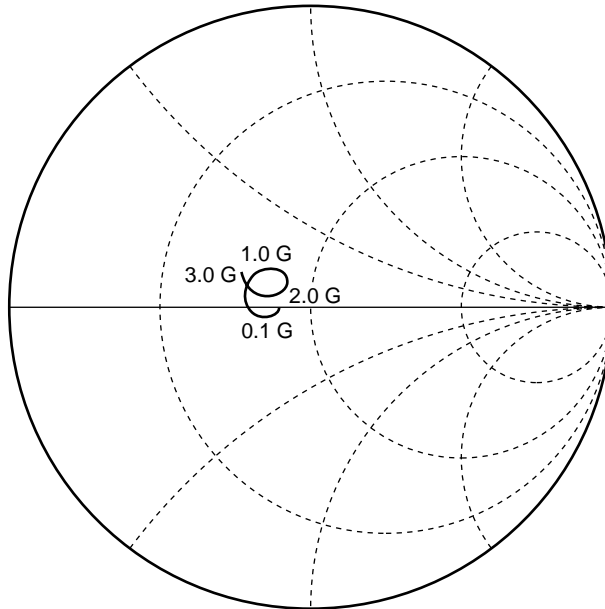


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

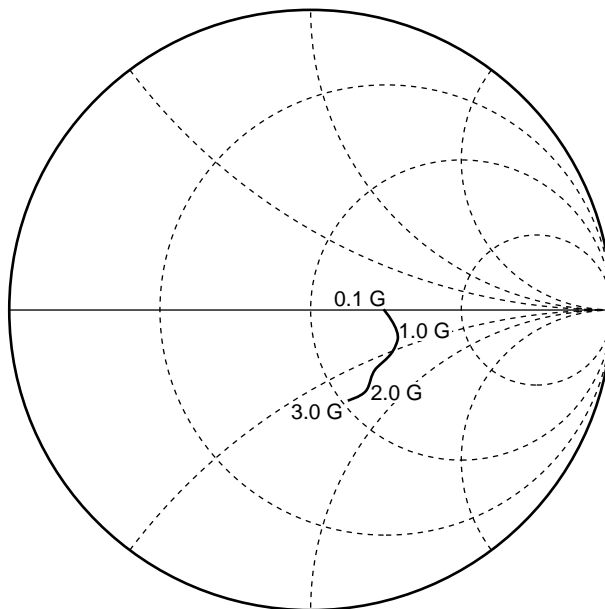
スミス・チャート ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 3.0\text{ V}$)

- μ PC2747TB -

S₁₁-周波数



S₂₂-周波数



S パラメータ**- μ PC2747TB -**

Sパラメータ/ノイズ・パラメータは当社Webサイトにて、シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式で提供しております。

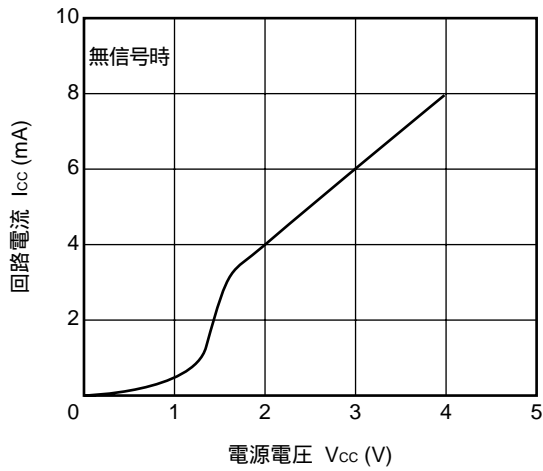
[RF&マイクロ波] → [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして、ご利用ください。

URL http://www.csd-nec.com/index_j.html

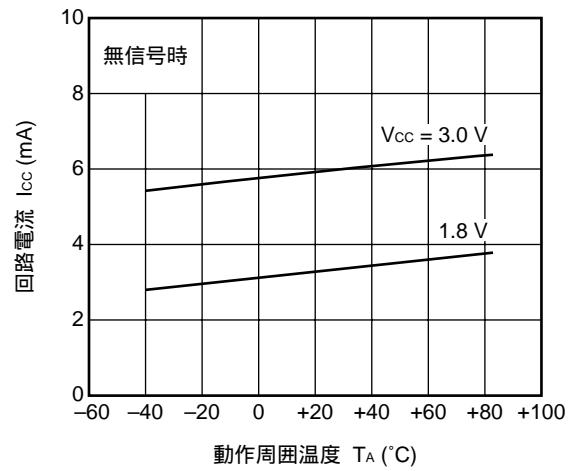
特性曲線 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$)

- μ PC2748TB -

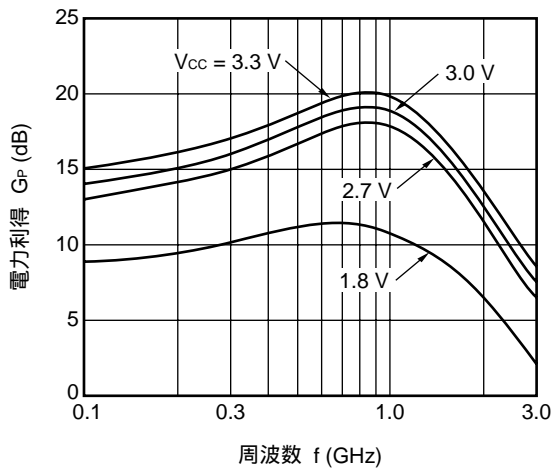
回路電流 vs. 電源電圧



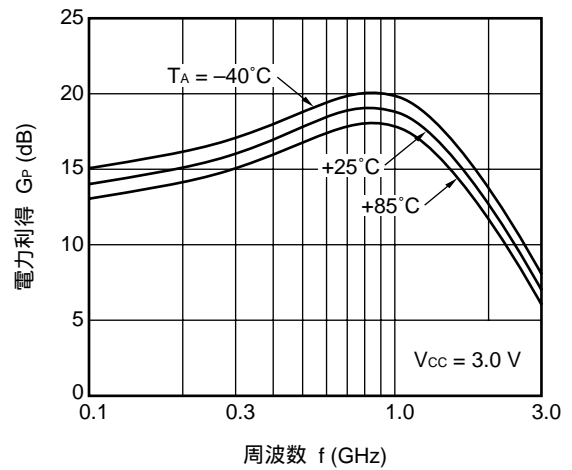
回路電流 vs. 動作周囲温度



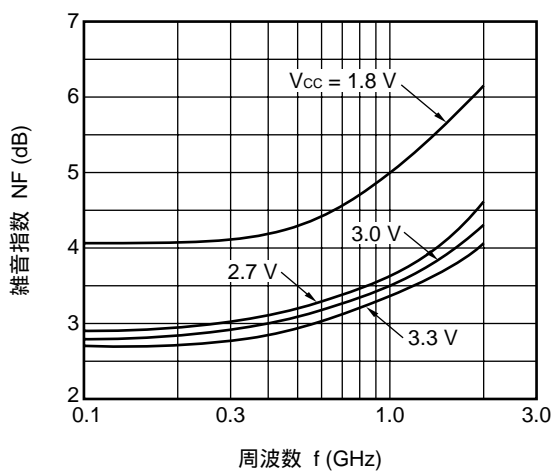
電力利得 vs. 周波数



電力利得 vs. 周波数

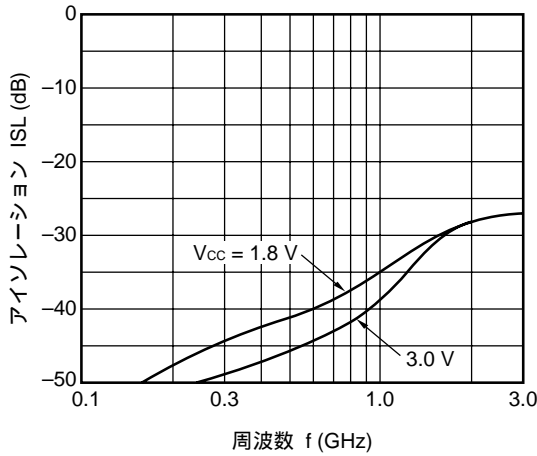


雑音指数 vs. 周波数

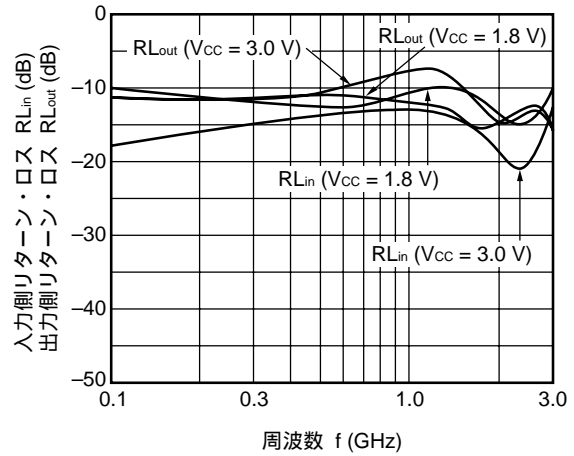


- μPC2748TB -

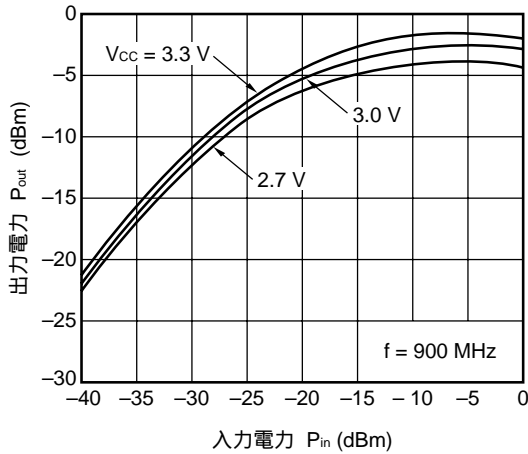
アイソレーション vs. 周波数



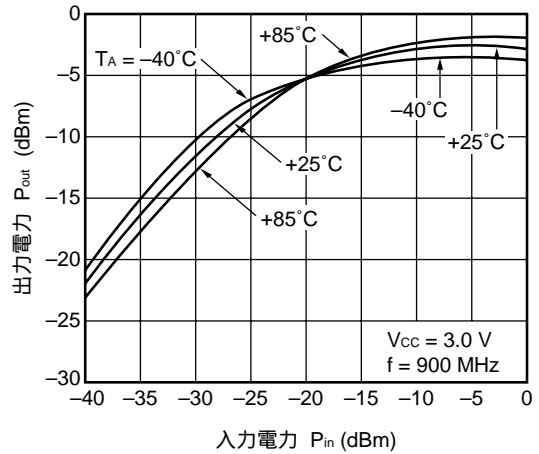
入力側リターン・ロス, 出力側リターン・ロス vs. 周波数



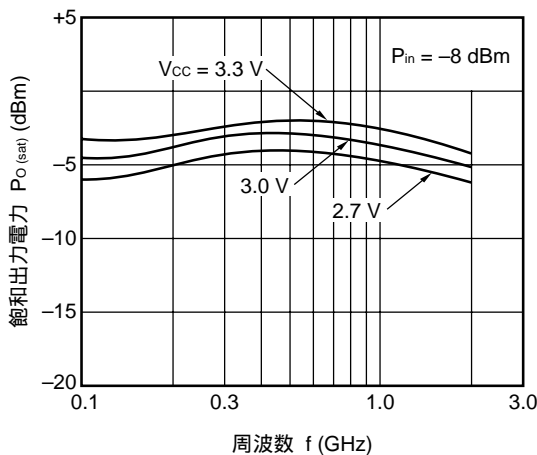
出力電力 vs. 入力電力



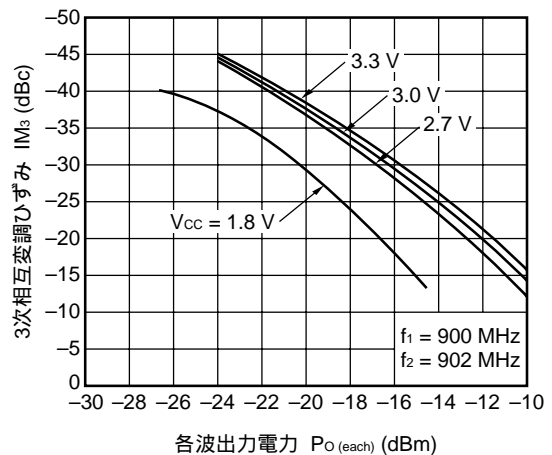
出力電力 vs. 入力電力



飽和出力電力 vs. 周波数



3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力

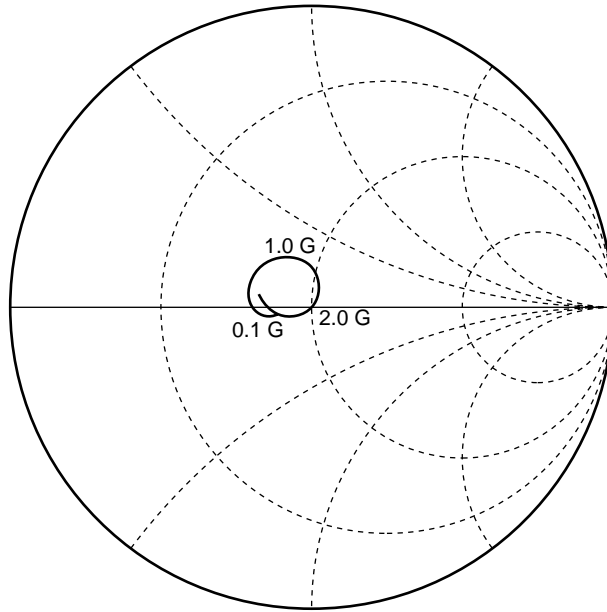


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

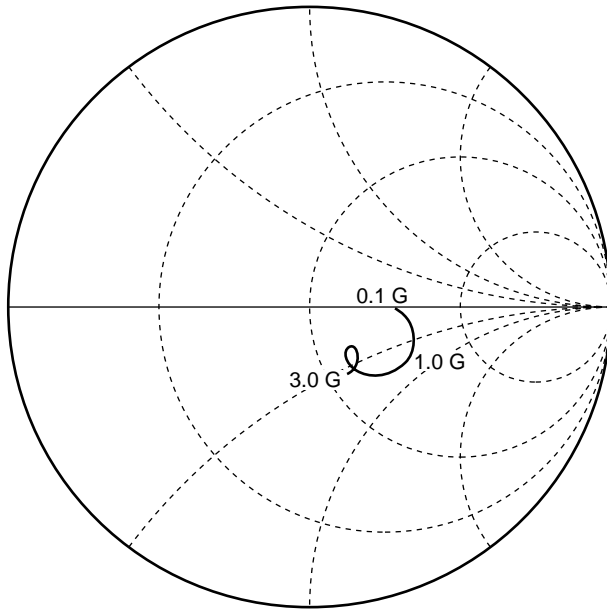
スミス・チャート ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 3.0\text{ V}$)

- μ PC2748TB -

S₁₁-周波数



S₂₂-周波数



S パラメータ**- μ PC2748TB -**

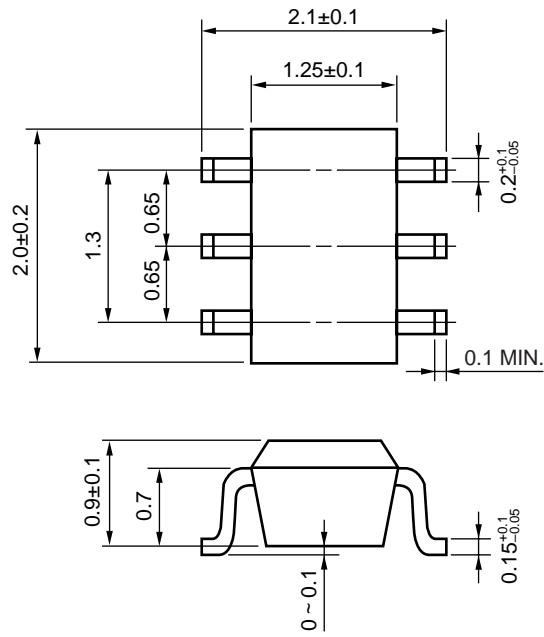
Sパラメータ/ノイズ・パラメータは当社Webサイトにて、シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式で提供しております。

[RF&マイクロ波] → [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして、ご利用ください。

URL http://www.csd-nec.com/index_j.html

外形図

6ピン小型ミニモールド (単位 : mm)



使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc 端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 入力端子は信号源と DC カット・コンデンサでカップリングしてください。

★ **半田付け推奨条件**

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 260°C 以下 ・ 最高温度の時間 : 10 秒以内 ・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒 ・ 最多次リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	IR260
VPS	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 215°C 以下 ・ 温度 200°C 以上の時間 : 25 ~ 40 秒 ・ プリヒート温度 120 ~ 150°C の時間 : 30 ~ 60 秒 ・ 最多次リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	VP215
ウェーブ・ソルダーリング	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (溶融半田温度) : 260°C 以下 ・ フロー時間 : 10 秒以内 ・ プリヒート温度 (パッケージ表面温度) : 120°C 以下 ・ フロー回数 : 1 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (端子部温度) : 350°C 以下 ・ 時間 (デバイスの一辺あたり) : 3 秒以内 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	HS350

注意 半田付け方式の併用は避けください (ただし、端子部分加熱は除く)。

NESAT は NEC 化合物デバイス株式会社の登録商標です。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
 - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
 - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
 - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.csd-nec.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先

営業本部 事業推進グループ TEL: 03-3798-6372
E-mail: salesinfo@csd-nec.com
FAX: 03-3798-6783

技術に関する問い合わせ先

営業本部 販売技術グループ E-mail: techinfo@csd-nec.com
FAX: 044-435-1918